

# 次世代ものづくりソリューション Part3

## ～先進的要素技術と研究シーズの紹介～

大阪府立大学研究推進機構21世紀科学研究センターに所属する「ものづくりイノベーション研究所」では、ものづくり企業の研究開発・試作機能を担い、共同研究等を通して、企業における研究・開発・試作・評価を支援し、産業振興への寄与を目指しています。今回は2016年のPart1ならびに昨年2018年Part2で好評を得た次世代ものづくりソリューションのPart3として、大阪府立大学より4名の講師をお迎えし、最新研究シーズの講演をお願いします。

つきましては、日頃よりものづくり技術や、新素材開発に高い関心をお持ちの企業の皆様に、また産学連携を希望する皆様のビジネスの一助となりますようご案内申し上げます。

[参加申込書](#)

[会場案内](#)

[開催要領](#)

### ◆講演会

①『表面構造を制御した超合金上へのTi系硬質膜の低温形成』 **材料工**  
**学系**

講師：齊藤 丈靖 大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・化学系専攻 化学工学分野 教授

②『医用・環境応用にむけた新規水酸化物材料の開発  
～水溶液中でのナノ結晶合成とその3次元構造構築～』 **材料工**  
**学系**

講師：徳留 靖明 大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・化学系専攻  
マテリアル工学分野 准教授

③『次世代ものづくり基盤技術のICT/IoT技術について』 **機械工学系**

講師：土井 智晴 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科  
メカトロニクスコース 教授

④『機械学習・理論計算・フロー光化学に基づく  
有機半導体材料の新規開発』 **応用化**  
**学系**

講師：池田 浩 大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・化学系専攻 応用化学分野 教授

### ◆ポスターセッション パネル前での解説及び質疑応答

### ◆交流・名刺交換会 参加者・講師・関係スタッフ全員による懇親会(立食形式)

日時：2019年9月18日(水) 13:30～18:30

会場：大阪府立大学 I-site なんば

参加費：無料(交流会を含む)

募集締：2019年9月11日(水)

切